

深圳佰易电子强势推出 SOD123FL 和 SMAF 封装产品线，

前言

1. 安森美半导体早在 2003 年就推出了适合 1A~3A 的整流二极管、肖特基二极管、稳压管以及 TVS 器件的小封装高功率密度的 SOD123FL 封装。该新型封装的器件可直接替代电路板中的 SMA (D0214A) 或者 DO-213AA 等封装的器件。优秀的热设计，在体积减少的情况下性能有所提高。SOD123FL 封装的 W/mm² 热密度较 SOD123 提高 149%；较 SMA 提高 90.5%；较 Power Mite 提高 26.5%。我们同样以 SOD123FL 封装的三明治引线结构设计，有更低的热阻和更好的抗浪涌电流能力，适合整流、续流以及瞬态电压抑制应用，并有更好的可靠性。SOD123FL 采用 100%锡 (Sn) 涂覆所有外表电镀面。其在 260° C 下回焊，达到 1 级潮湿敏感度等级 (MSL)，同时与现有回焊工艺逆向相容。

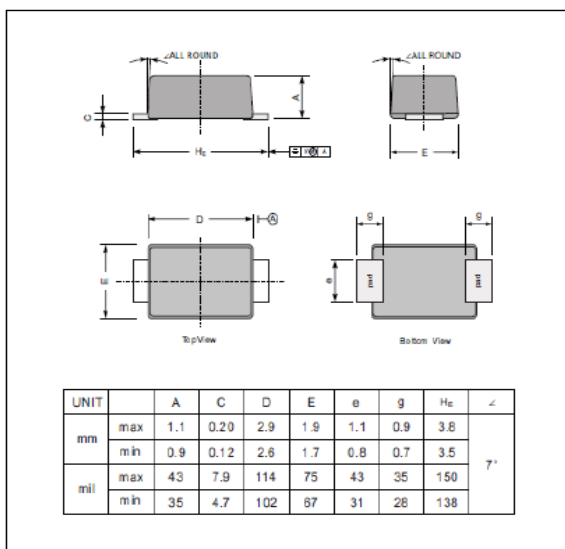
2. 超薄的 SMA (SMAF) 封装，此产品采用超薄、灵活、优化新型设计，高度小于 1.1MM，比普通打扁 SMA 的 2.25MM 和框架 SMA 的 2.1MM 薄 50%，直接代替打扁 SMA 与框架 SMA 产品使用：电流容量大，GPP 玻璃钝化涵盖 1A-2A, Schottky 肖特基涵盖 1-5A，采用框架焊接式工艺 提供了高可靠性和电流容量大等特性，低热阻低结温高抗浪涌设计，引线平贴器件底部，散热路径短，改进了用于硅芯片散热的片状引线框架的外形，抗正向浪涌能力强，实现了小体积大功率的技术突破。

3. 工厂直销 可为客户特需订单量身定做 质量一流 价格最低，售后服务到位。

PACKAGE OUTLINE

Plastic surface mounted package; 2 leads

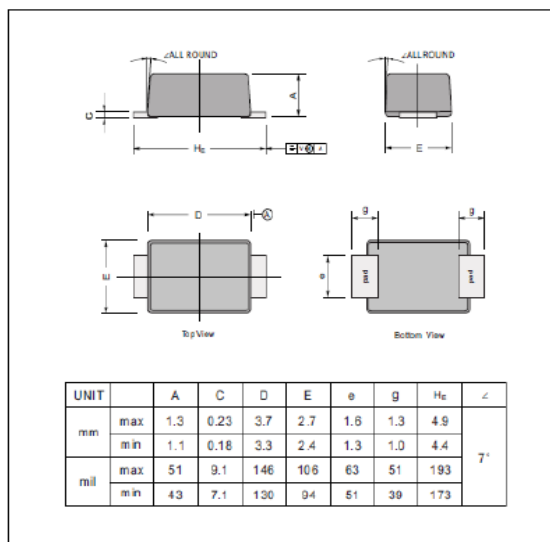
SOD123FL



PACKAGE OUTLINE

Plastic surface mounted package; 2 leads

SMAF



SOD-123FL 封装系列:

1N4001W---1N4007W SS1020---SS10100FL
 FR102W---FR107W DS12W---DS110W
 US1AW---US1MW DS22W---DS220W
 ES1AW---ES1JW DS32W---DS36W
 GS1001FL---ES1008FL
 US1001FL---US1008FL

SMAF 封装系列:

RS1AF---RS1MF
 US1AF---US1MF
 ES1AF---ES1JE
 SS12F---SS120F
 SS22F---SS220F
 SS32F---SS320F